

杭州中威电子股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币7.5亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等。上述综合授信额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准；

2、上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行等金融机构协商确定。

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

4、本次授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日